

第54期 中間報告書

平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで



株主の皆さまへ



代表取締役社長·CEO 河合 利樹

目次

株主の皆さまへ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
事業の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
主要な事業内容及びセグメント別の概況・・・	3
▼ 特集① 平成29年3月期 中間期トピックス・・・・	5
特集② 当社グループ事業拠点のご紹介	
東京エレクトロン東北(株)・・・・・・・	7
■ 連結財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
■ 株式の状況・・・・・・・1.	2
■ 会社の概況等1	3
株主メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.	1

株主の皆さまには、平素より格別のご支援 を賜り厚く御礼申しあげます。

第54期中間期(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)報告書として、事業の概況等をご報告するにあたり、ご挨拶申しあげます。

第54期中間期の連結業績は、売上高、利益ともに期初からの想定を上回ることができました。これもひとえに株主の皆さまのご支援の賜物と感謝しております。

半導体の技術革新が続いていくなかで、求められる技術が高度になるほど、製造装置メーカーとしての総合力が必要とされ、当社はこれを事業拡大のチャンスととらえております。『革新的な技術力と、多様なテクノロジーを融合する独創的な提案力で、半導体産業とFPD産業に高い付加価値と利益を生み出す真のグローバルカンパニー』というビジョンのもと企業価値の向上に努めてまいる所存です。

株主の皆さまにおかれましては、一層のご 支援とご理解を賜りたく、よろしくお願い申し あげます。

平成28年11月

事業の概況

当中間期の世界経済は、全体としては緩やかな回復基調が続いているものの、中国の景気減速や英国のEU離脱選択等の影響による先行きの不透明感は払拭されていません。

その一方で、当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、デジタルデータ通信量の増加基調に伴う好調なサーバー需要や、モバイル機器におけるデータ処理の高機能化と大容量化を背景に、半導体・電子部品の需要は堅調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループの当中間期の連結業績は、売上高3,527億2千2百万円(前年同期比3.5%増)、営業利益600億1千2百万円(前年同期比2.0%減)、経常利益623億6千5百万円(前年同期比0.0%減)、また、親会社株主に帰属する当期純利益は419億6千6百万円(前年同期比1.4%増)となりました。

■連結業績推移







(第50期) (第51期) (第52期) (第53期) (第54期)

(注) △は損失を示しております。

(注) △は損失を示しております。

主要な事業内容及びセグメント別の概況

当社グループは、エレクトロニクス技術を利用した半導体製造装置及びFPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置の製造・販売を事業の中心としております。

半導体製造装置

■事業の状況

エレクトロニクス産業の市況を受け、ロジック系半導体メーカーによる先端技術への投資や、3次元構造のNANDフラッシュメモリー向けの投資が好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当中間期の外部顧客に対する売上高は、3,270億8百万円(前年同期比3.2%増)となりました。

■主要営業品目

- ■コータ/デベロッパ
- ●プラズマエッチング装置
- 熱処理成膜装置
- ●枚葉成膜装置
- ●洗浄装置
- ●ウェーハプローバ













FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

■事業の状況

モバイル端末用の中小型液晶パネル向けの設備投資が伸長したほか、大型液晶パネル向けの設備投資も続いており、FPD製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当中間期の外部顧客に対する売上高は、254億7千9百万円(前年同期比39.4%増)となりました。

■主要営業品目

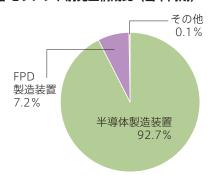
- ●FPDプラズマエッチング/アッシング装置
- ●FPDコータ/デベロッパ



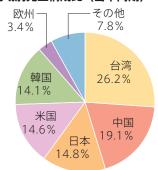
その他

上記2セグメントに含まれない事業における当中間期の外部顧客に対する売上高は、2億3千4百万円(前年同期比95.9%減)となりました。

■連結 セグメント別売上構成比(当中間期)



■連結 地域別売上構成比(当中間期)



特集① 平成29年3月期 中間期トピックス

熊本地震からの復旧

2016年4月14日午後9時26分 最大震度7 (M6.5)、4月16日午前1時25分 最大震度7 (M7.3) の地震が熊本地方で発生し、当社グループの主力工場の一つである合志事業所及び大津事業所が被害を受けました。

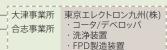
当社は、4月14日地震発生直後の午後9時50分には災害対策本部を立ち上げ、2003年より運用する当社策定の BCP (Business Continuity Plan-事業継続計画) のもと、グループー丸となっての復旧への取り組みにより、4 月25日には一部操業を再開し、6月末には通常の生産体制に戻しました。その後、上半期においては被災以前の計画を上回る生産台数を達成しました。

復旧へ向けた取り組み

災害対策本部	4月14日地震発生の直後速やかに災害対策本部を設置、復旧までに計17回の災害対策会議を実施		
従業員	事業所に勤務するグループ社員全員の無事を確認、住居及び支援物資の提供		
顧客対応	被災したお客さまへの支援、当社の被災状況を積極的に情報提供		
サプライヤー対応	被災したサプライヤーの方々への状況確認及び復旧支援		
地域支援	を援 熊本県への1億円の義援金拠出、被災地への支援物資提供		
情報発信 プレスリリース (計10回) などによるステークホルダーへのタイムリーな情報発信			



当社事業所と震源の位置関係







現地での支援の様子

今後もお客さまへの製品の安定供給を継続できるよう、BCPのさらなる強化に取り組みます。

インテル社よりSCOI賞を受賞

Intel Corporationから「サプライヤー・コンテニュアス・クオリティー・インプルーブメント(SCQI)賞」を受賞しました。本賞は、インテル社にとって重要な役割を果たしたサ



プライヤーに与えられる最も名誉ある賞で、2015年度に 選出された装置メーカーは当社のみでした。

*2016年3月の受賞ですが、ご紹介させていただきます。

URL: www.tel.co.jp/news/2016/0311_001.htm

産学官連携功労者表彰 内閣総理大臣賞を受賞

東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター(宮城県仙台市、センター長:遠藤哲郎氏)とともに産学官連携功労者表彰において内閣総理大臣賞を受賞しました。



URL: www.tel.co.jp/news/2016/0822_001.htm

DJSI Asia Pacific銘柄に選定

世界的な社会的責任投資の 株価指標である「ダウ・ジョー ンズ・サステナビリティ・ア ジア・パシフィック・インデッ



クス(DJSI Asia Pacific)」の構成銘柄に選定されました。当社は、アジア・太平洋地域の半導体及び半導体製造装置部門において、日本企業として唯一選出されました。

URL: www.tel.co.jp/news/2016/0914_001.htm

Institutional Investor誌より Most Honored Companyに選定

世界的に著名な米国大手金融情報誌Institutional Investorが発表したベストIR企業ランキングの電気・精密セクターにおいて、株主価値向上への取り組みが総合的に評価され、「Most H



総合的に評価され、「Most Honored Company」に選 定されました。

URL: www.tel.co.jp/news/2016/0606_001.htm

東京エレクトロン宮城(株) エッチング装置 プロセスチャンバー 5,000台出荷を達成

東京エレクトロン宮城(株)竣工5 周年の節目の年に、エッチング装置プロセスチャンバー5,000台出荷を達成しました。



URL: www.tel.co.jp/news/2016/0615_001.htm

枚葉成膜装置Triase+™ EX-II™ TiON の受注を開始

枚葉メタル成膜装置Triase+™EX-II™ TiONの受注を2016年8月より開始しました。本装置は半導体の微細化の要求に性能、コストの両面から貢献します。Triase+EX-IIシリーズは、今後も扱う膜種の拡充に努めてまいります。



URL: www.tel.co.jp/news/2016/0808_001.htm

特集② 当社グループ事業拠点のご紹介-東京エレクトロン東北(株)-

当社主力装置の製造拠点である東京エレクトロン東北(株)をご紹介します。



東京エレクトロン東北株式会社

所 在 地:岩手県奥州市 設 寸:2006年4月

※1968年、米国サームコ社との合弁会社テル・サームコ(株)にて

事業を開始

代表者:代表取締役社長 佐々木貞夫

主要事業:半導体製造装置(熱処理成膜装置)の

開発・設計・製造

資本金:10億円 従業員:約880名

半導体製造工程のうち、半導体デバイスの3次元化に伴って市場の伸びが期待できる熱処理成膜装置の開発・設計・ 製造を担っています。

当社の熱処理成膜装置は、摂氏400~1,100度の温度域を±1度の精度でコントロールする制御技術に優れており、25~150枚のウェーハを一括処理できるという特長を持っています。

また、原子レベルでの膜厚制御が可能なALD(原子層堆積)装置は、半導体の微細化プロセスや次世代メモリー向けに需要が拡大しています。



<主力製品ラインアップ>



ALD(原子層堆積)装置 NT333™



熱処理成膜装置 TELINDY PLUS™



熱処理成膜装置 TELFORMULA™



連結財務諸表連結貸借対照表

期別科目	第54期 中間期	第53期 (平成28年3月31日現在)	増減
(TML0+7月30日※虹/ (TML0+7月31日※虹/ 資産の部			
流動資産	670,210	617,416	52,794
現金及び預金	96,957	75,674	
受取手形及び売掛金	149,283	116,503	
有価証券	158,700	160,999	
商品及び製品	133,131	130,478	
仕掛品	46,806	41,556	
原材料及び貯蔵品	24,991	23,044	
その他	60,395	69,207	
貸倒引当金	△ 54	△ 48	
固定資産	169,836	175,951	△ 6,115
有形固定資産	96,191	96,316	△ 125
無形固定資産	15,001	17,603	△ 2,601
投資その他の資産	58,644	62,031	△ 3,387
その他	60,420	63,857	
貸倒引当金	△ 1,776	△ 1,825	
資産合計	840,047	793,367	46,679

			(単位:百万円)	
期別 科目	第54期 中間期 _(平成28年9月30日現在)	第53期 (平成28年3月31日現在)	増減	
負債の部				
流動負債	197,713	166,060	31,652	
支払手形及び買掛金	59,008	55,050		
未払法人税等	18,199	22,460		
賞与引当金	17,190	11,623		
その他の引当金	8,607	10,108		
その他	94,707	66,818		
固定負債	62,621	63,067	△ 446	
その他の引当金	374	374		
退職給付に係る負債	56,301	55,302		
その他	5,944	7,390		
負債合計	260,334	229,128	31,206	
純資産の部				
株主資本	576,238	552,551	23,686	
資本金	54,961	54,961		
資本剰余金	78,023	78,023		
利益剰余金	451,153	427,618		
自己株式	△ 7,899	△ 8,050		
その他の包括利益累計額	552	9,817	△ 9,265	
その他有価証券評価差額金	5,889	7,902		
繰延ヘッジ損益	6	50		
為替換算調整勘定	△ 686	6,742		
退職給付に係る調整累計額	△ 4,656	△ 4,877		
新株予約権	2,683	1,641	1,042	
非支配株主持分	237	228	8	
純資産合計	579,712	564,239	15,473	
負債純資産合計	840,047	793,367	46,679	

⁽注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

~			(単位:白万円)
料目	第54期 中間期 (平成28年4月1日から) 平成28年9月30日まで)	第53期 中間期 (平成27年4月1日から) 平成27年9月30日まで)	
売上高	352,722	340,951	11,771
売上原価	214,032	204,940	
売上総利益	138,689	136,010	2,679
販売費及び一般管理費	78,677	74,759	
研究開発費	39,805	37,578	
その他	38,871	37,181	
営業利益	60,012	61,250	△ 1,237
営業外収益	2,483	1,725	757
為替差益	946	32	
その他	1,537	1,693	
営業外費用	131	591	△ 460
閉鎖拠点維持管理費用	55	91	
自己株式取得費用	_	360	
その他	75	139	
経常利益	62,365	62,384	△ 19
特別利益	50	998	△ 948
固定資産売却益	43	998	
その他	6	_	
特別損失	7,994	5,864	2,130
減損損失	_	4,434	
災害による損失	7,828	_	
その他	166	1,429	
税金等調整前当期純利益	54,420	57,519	△ 3,099
法人税等	12,426	16,123	
当期純利益	41,993	41,396	597
非支配株主に帰属する当期純利益	27	19	
親会社株主に帰属する当期純利益	41,966	41,376	589

⁽注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

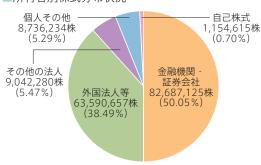
期別	第54期中間期	第53期中間期	増減
	(平成28年4月1日から) 平成28年9月30日まで)	(平成27年4月1日から) 平成27年9月30日まで)	
税金等調整前当期純利益	54,420	57,519	
減価償却費	8,199	9,376	
減損損失	_	4,434	
のれん償却額	307	628	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,900	△ 1,318	
関係会社株式売却損益 (△は益)	_	1,110	
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 37,023	△ 420	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 15,353	△ 6,195	
仕入債務の増減額 (△は減少)	6,634	△ 11,168	
未収消費税等の増減額(△は増加)	11,475	13,480	
前受金の増減額 (△は減少)	29,410	△ 4,798	
その他	8,106	△ 8,302	
小青十	72,077	54,346	17,731
利息及び配当金の受取額	659	608	
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 20,729	△ 7,378	
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,007	47,576	4,431
定期預金の増減額 (△は増加)	_	12	
短期投資の増減額 (△は増加)	△ 5,201	△ 108,492	
有形固定資産の取得による支出	△ 9,631	△ 4,713	
無形固定資産の取得による支出	△ 320	△ 305	
その他	85	1,684	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,068	△ 111,814	96,745
自己株式の取得による支出	△ 4	△ 88,756	
配当金の支払額	△ 18,371	△ 12,190	
その他	△ 1	△ 53	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,377	△ 101,000	82,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 4,775	△ 189	△ 4,585
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	13,786	△ 165,427	179,214
現金及び現金同等物の期首残高	95,638	317,632	△ 221,993
現金及び現金同等物の期末残高	109,425	152,204	△ 42,779
「現金及び現金同等物の期末残高」並びに短期投資等 合計額(注2)	255,657	260,737	△ 5,080

⁽注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヵ月を超える定期預金及び短期投資を加えた残高を示しており ます。

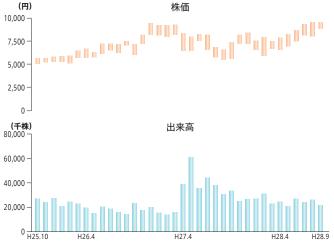
株式の状況 (平成28年9月30日現在)

発行可能株式総数 300,000,000株 発行済株式の総数 165,210,911株 株主数 21,364名

■所有者別株式分布状況



株価と出来高 (平成25年10月~平成28年9月)

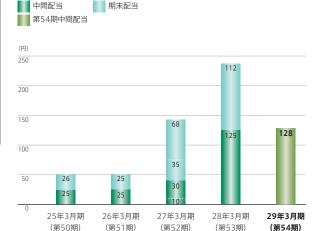


大株主の状況

株主名	持株数 (千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	26,342	16.05
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	18,948	11.54
株式会社東京放送ホールディングス	7,727	4.71
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	4,219	2.57
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	3,680	2.24
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	3,245	1.97
ステートストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225	2,606	1.58
BNPパリバ証券株式会社	2,444	1.48
ザバンクオブニユーヨークメロンエスエーエヌブイ10	2,309	1.40
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)	2,254	1.37

- (注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。2. 持株比率は、自己株式(1,154,615株)を控除して算出しております。
 - また、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
 3. 平成28年2月1日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である他2社が平成28年1月25日現在、14,461千株所有している旨、平成28年2月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である他2社が平成28年1月29日現在、12,748千株所有している旨、平成28年3月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者である他2社が平成28年2月29日現在、11,145千株所有している旨、平成28年2月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャバン株式会社及びその共同保有者である他6社が平成28年1月29日現在、10,252千株所有している旨が記載されておりますが、当社として平成28年9月30日現在の実質保有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。

配当金の推移



- (注) 1. 平成28年3月期から配当性向を見直し、親会社株主に帰属する当期 純利益に対する配当性向50%を目途としております。
 - 2. 平成27年3月期は四半期配当を実施しております。

会社の概況等

会社の概況 (平成28年9月30日現在)

商 号 東京エレクトロン株式会社

TOKYO ELECTRON LIMITED

設 立 昭和38年11月11日

資本金 54,961,191,468円

本 社 東京都港区赤坂五丁目3番1号

主要な事業所

府中テクノロジーセンター 東京都府中市住吉町二丁目30番地の7

大阪支社 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

山梨事業所

(藤井地区) 山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

(穂坂地区) 山梨県韮崎市穂坂町三ッ沢650番地

札幌事業所 北海道札幌市中央区南一条東一丁目5番

九州営業所 熊本県合志市福原1番地1

取締役・監査役 (平成28年9月30日現在)

取締役会長	常石	哲男
代表取締役社長	河合	利樹
代表取締役	佐々オ	夫真才
代表取締役	堀	哲朗
取締役	鄭	基市
取締役	飽本	正巳
取締役	長久傷	R達也
取締役	北山	博文
取締役相談役	東	哲郎
取締役(社外)	井上	弘
取締役(社外)	チャール) (Charle	ズレイク s Lake)
常勤監査役	原田	芳輝
常勤監査役	森章	重次郎
常勤監査役(社外)	赤石	幹雄
監査役(社外)	山本	高稔
監査役(社外)	酒井	竜児

株主メモ

事 業 年	度	4月1日から翌年の3月31日まで
定 時 株 主	総 会	事業年度終了後3ヵ月以内
基準	日	定時株主総会については、毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主	確定日	期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
単 元 株	式 数	100株
株 主 名 簿 管 理 特別口座の口座管	人 及 び 宮理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
郵 便 物 送 電 話 照 :	付 先 会 先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-782-031(フリーダイヤル)
単元未満株 買取請求	式 の 取 扱	お取引証券会社等(特別口座で管理されている場合は特別口座の口 座管理機関である三井住友信託銀行株式会社)
公 告 方	法	電子公告 (電子公告アドレス http://www.tel.co.jp/ir/stocks/koukoku/) ただし、電子公告をすることができない事故その他のやむを得ない 事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
上場金融商品	取引所	東京証券取引所 市場第一部 (証券コード 8035)

配当金のお支払いについて

第54期中間配当金は、同封の「配当金領収証」により、平成28年11月28日から平成29年1月13日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行等でお受け取りください。金融機関預金口座振込・ゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」のとおり、また、証券会社等の口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」のとおり振込手続きをいたしましたので、ご確認ください。





